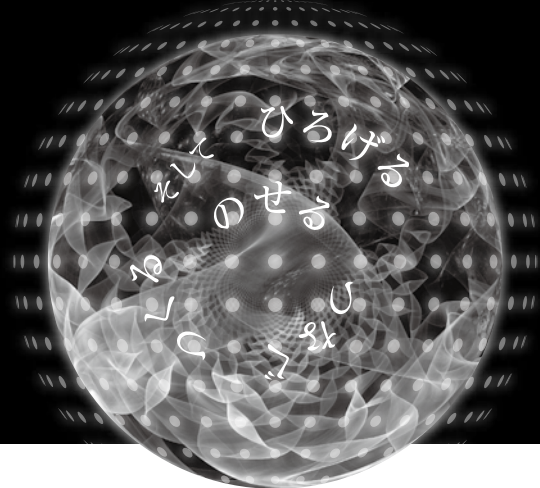


世界唯一にして最大規模！産学連携開催

電子機器2017

トータルソリューション展

www.jpccashow.com



JPCA 2017
Show
第47回国際電子回路産業展
主催：一般社団法人日本電子回路工業会

JIEP 2017
マイクロエレクトロニクスショー
第31回 最先端実装技術・パッケージング展
主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 (JIEP)

JISSO
PROTEC 2017
第19回 実装プロセステクノロジー展
主催：一般社団法人日本ロボット工業会



ラージエレクトロニクスショー2017
主催：一般社団法人日本電子回路工業会・電子デバイス産業新聞 (産業タイムズ社)



WIRE Japan Show
2017

電線・ケーブル・コネクタ総合技術展
主催：一般社団法人日本電子回路工業会・電線新聞 (株)工業通信

結果報告書

出展者数：456社 小間数：1,355小間 / 来場者数 43,184名

2017 **6.7** WED. ▶ **6.9** FRI. 10:00-17:00

東京ビッグサイト Tokyo Big Sight, Japan

www.jpccashow.com

本部事務局：一般社団法人日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 回路会館 2F TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpca.org

展示会運営事務局：株式会社 JTB コミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpccashow@jtbcom.co.jp

ご挨拶

「電子機器トータルソリューション展2017(JPCA Show / マイクロエレクトロニクスショー / JISSO PROTEC / ラージエレクトロニクスショー / WIRE Japan Show)」は、2017年6月7日(水)～9日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催され、出展者数456社、出展小間数1,355小間と盛況裡に無事終了することができました。

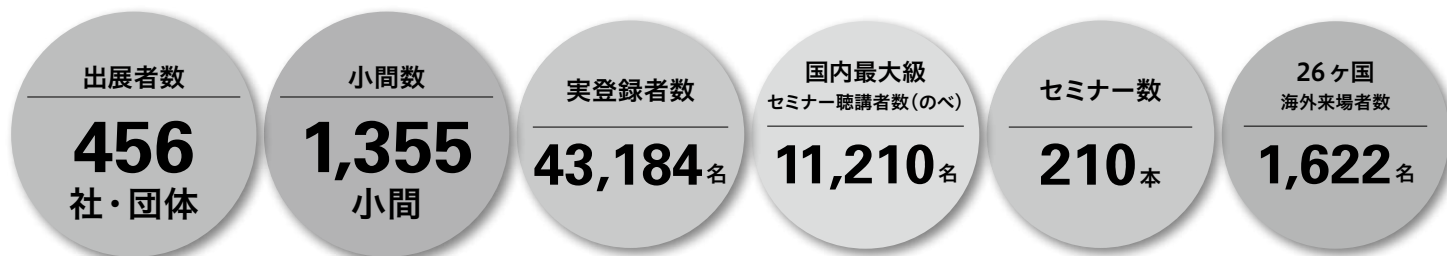
これもひとえに、ご後援を賜りました経済産業省、独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部をはじめ、協賛・特別協力団体各位、ご出展いただきました多くの企業の皆様のご支援とご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。

次回開催は、2018年6月6日(水)～8日(金)「電子機器トータルソリューション展2018」を予定しておりますので、ご出展・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ここに、今回の結果を取りまとめてご報告申し上げますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

開催 TOPICS ①：展示会結果概要

展示会・セミナーともに大盛況!



開催 TOPICS ②：JPCA 賞 (アワード) を展示会場にて実施

JPCA 賞 (アワード) 選考委員会にて、厳正なる審査の上、第13回 JPCA 賞受賞企業が下記の通り決定致しました。

第13回 JPCA 賞

新世代エレクトロニクスの可能性を切り開く新ダイレクトパターンニングめっき技術 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社

基材の任意の場所に Au ナノ粒子触媒を自動吸着させ、めっき法によりプラスチックフィルムやガラス上に直接配線形成する技術を開発した。「100°C 以下のプロセス」で「レジストを使わず」に「様々な金属」の「低抵抗な微細配線形成」を可能にした、新規ダイレクトパターンめっき技術の紹介をした。

無線基地局向け 高熱伝導率・低伝送損失ハロゲンフリー多層基板材料 R-5575 (ラミネート) / R-5470 (プリプレグ) パナソニック株式会社

激増するデータトラフィックに対応するため、第5世代移動通信システムである「5G」の実用化に向けた取組みが業界各社で加速している。この動向の中、無線基地局向けに新たに高熱伝導率・低伝送損失のハロゲンフリー多層材を開発した。

耐熱絶縁処理剤によるダイカストローターの漏れ電流抑制技術 日本パーカライジング株式会社

ダイカストにより製造されるローターの導体部であるスロットと鋼板間に生じる漏れ電流は、効率低下や発熱の原因となってモータの特性を損なう。当社はダイカスト時の温度が1200度を越える溶融銅に耐える耐熱絶縁皮膜を開発した。本皮膜はスロットと鋼板間の絶縁を確保し、漏れ電流を抑制することが可能である。

微細加工用感光性材料の開発動向 日立化成株式会社

最新の半導体パッケージ基板の要求配線ルールは、ラインアンドスペース10 μm 以下と超微細化が進んでおり、更に5 μm を下回る微細配線を検討するケースもでてきている。プリント配線板メーカーでは、微細回路形成に有利とされる液状材料やポジ型感光性材料を検討される一方、既存の量産設備が適用でき、生産性に優れたネガ型感光性フィルムを適用したいとの意向が高い。そこで、上記微細回路形成を実現できる感光性フィルムの開発手法、今後の動向について報告した。



開催TOPICS③：開会式・ウェルカムレセプション

開会式

●日 時：6月7日(水) 9:45～10:00

●会 場：東京ビッグサイト 東7・8ホールリンクスペース

御来賓	渡邊 昇治	経済産業省 商務情報政策局 商務情報政策	課長
開催挨拶	小林 俊文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
	山本 治彦	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	益 一哉	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	会長
	青田 広幸	一般社団法人日本ロボット工業会	副会長
	泉谷 涉	株式会社産業タイムズ社	代表取締役社長
	井上 政基	株式会社工業通信	代表取締役社長
	Won-Ki Nam	世界電子回路業界団体協議会 (WECC)	事務総長
	Wu Shou Kun	中国電子回路行業協会 (CPCA)	副会長
	Paul Waldner	欧州電子回路協会 (EIPC)	理事
	M Anil Kumar	インド電子工業会 (ELCINA)	理事
	Robert Ho	香港線路板協会 (HKPCA)	代表
	John Mitchell	米国電子回路協会 (IPC)	専務理事
	Jung Bong Hong	韓国電子回路産業協会 (KPCA)	会長
	Rick Wu	台湾電路板協会 (TPCA)	会長

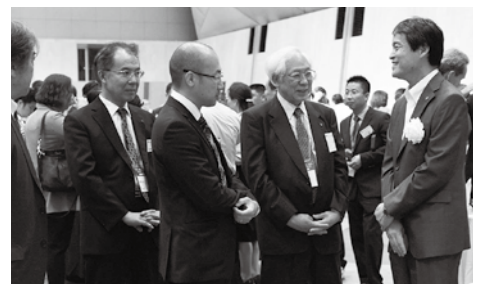
ウェルカムレセプション

出展企業および業界関係者800名が参加。御来賓として井原 巧 経済産業大臣政務官にご挨拶をいただいた。

●日 時：6月7日(水) 17:30～19:30

●会 場：東京ビッグサイト レセプションホール

開催挨拶	泉谷 涉	株式会社産業タイムズ社	代表取締役社長
来賓挨拶	井原 巧	経済産業省	経済産業大臣政務官
乾杯発声	青田 広幸	一般社団法人日本ロボット工業会	副会長
中締挨拶	白石 洋一	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	副会長
乾杯登壇	小林 俊文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
	山下 博樹	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	山本 治彦	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	岩城 慶太郎	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	佐藤 英志	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	松本 博文	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	展示会事業委員長
	須原 信介	一般社団法人日本ロボット工業会	JISSO PROTEC 2017 運営委員会 曾我 信之 委員代理
	濱 学洋	一般社団法人日本ロボット工業会	JISSO PROTEC 2017 運営委員会委員
	太田 裕之	一般社団法人日本ロボット工業会	JISSO PROTEC 2017 運営委員会委員
	井上 政基	株式会社工業通信	代表取締役社長



実施概要



(一社)日本電子回路工業会
会長 小林俊文



展示会運営委員会
委員長 山本治彦



(一社)エレクトロニクス実装学会
会長 益一哉



(一社)日本ロボット工業会
会長 稲葉善治



(株)産業タイムズ社
代表取締役社長 泉谷渉



(株)工業通信
代表取締役社長 井上政基

■ 会 期：2017年6月7日(水)～9日(金)

■ 開催時間：10:00～17:00

■ 会 場：東京ビッグサイト 東4～8ホール

■ 名 称：**JPCA Show 2017 第47回国際電子回路産業展**

主 催：一般社団法人日本電子回路工業会

構成展示会：2017プリント配線板技術展

2017半導体パッケージング・部品内蔵技術展

2017機器・半導体受託生産システム展

JISSO PROTEC 2017 第19回実装プロセステクノロジー展

主 催：一般社団法人日本ロボット工業会

WIRE Japan Show 2017 電線・ケーブル・コネクタ総合技術展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会

電線新聞(株式会社工業通信)

2017マイクロエレクトロニクスショー 第31回最先端実装技術・パッケージング展

主 催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会

ラージエレクトロニクスショー2017

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会

電子デバイス産業新聞(株式会社産業タイムズ社)

構成展示会：2017プリントエレクトロニクス最適生産システム展

2017部品・MEMS/デバイス産業総合資機材展

2017LED/OLED応用技術展

JPCA Show × ラージエレクトロニクスショー

構成展示会：IoTエレクトロニクス実装展

ウェアラブルエレクトロニクス実装展

■ 後 援：経済産業省、独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部、アメリカ大使館商務部、在日カナダ大使館

■ 特別協力：国立研究開発法人産業技術総合研究所、一般社団法人組込みシステム技術協会(JASA)、一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA)、SEMI ジャパン、一般財団法人日本品質保証機構(JQA)

■ 海外協力：世界電子回路業界団体協議会(WECC)加盟団体—中国電子回路行業協会(CPCA)、欧州電子回路協会(EIPC)、香港線路板協會(HKPCA)、米国電子回路協会(IPC)、インド電子回路工業会(IPCA)、インド電子工業会(ELCINA)、韓国電子回路産業協會(KPCA)、台湾線路板協會(TPCA)

■ 展示会本部事務局：一般社団法人 日本電子回路工業会

■ 協 賛：映像情報メディア学会、画像センシング技術研究会、画像電子学会、カメラ映像機器工業会、自動車技術会、写真感光材料工業会、情報サービス産業協会、情報処理学会、全国鍍金工業組合連合会、電気安全環境研究所、電気学会、電気機能材料工業会、電気設備学会、電子情報技術産業協会、電子情報通信学会、銅箔工業会、日本アミューズメントマシン協会、日本医療機器工業会、日本医療機器テクノロジー協会、日本印刷産業連合会、日本オーディオ協会、日本音響学会、日本化学工業協会、日本火災報知機工業会、日本金型工業会、日本機械工業連合会、日本金属熱処理工業会、日本計量機器工業連合会、日本検査機器工業会、日本産業機械工業会、日本自動車研究所、日本自動車部品工業会、日本真空学会、日本真空工業会、日本精密測定機器工業会、日本電気協会、日本電気計測器工業会、日本電機工業会、日本電気制御機器工業会、日本電子部品信頼性センター、日本照明工業会、日本電線工業会、日本配線システム工業会、日本半導体製造装置協会、日本表面処理機材工業会、日本品質保証機構、日本ファインセラミックス協会、日本分析化学会、日本分析機器工業会、日本ベアリング工業会、日本遊技関連事業協会、日本溶接協会、光産業技術振興協会、ビジネス機械・情報システム産業協会、表面技術協会、ファインセラミックスセンター、プリントエレクトロニクス研究会、太陽光発電技術研究組合、次世代化学材料評価技術研究組合、技術研究組合光電子融合基盤技術研究所、日本材料科学会、情報通信ネットワーク産業協会、コンピュータソフトウェア協会

■ 展示会運営事務局：株式会社JTBCコミュニケーションデザイン

出展者サービス

会期中のみならず、会期前後も含めて長期間にわたって出展効果を高めていただくために今年より新たなサービスを追加し、ご好評いただいた。

● [NEW] プレスセンターの設置

会期中記者会見を実施し、出展者の方々にプレス向けにPRできる場を提供。

多くの出展者・団体にご活用いただいた。

● [NEW] 出展者プレスリリース

展示会公式サイト内のトップページに、気軽にプレスリリースを掲載できるシステムを構築。

ブースへの来場者誘致を含めた、PRの場としてご活用いただいた。



● [NEW] 展示会特集記事

2万部の発行部数を誇り、業界内での知名度も高い「電子デバイス産業新聞」と連携し、展示会特集を連載。記事が掲載されることで、効果的に業界内での認知度向上にご活用いただいた。

● 出展者 (NPI) プレゼンテーション

NPI専用の会場をご用意。プレゼンテーションを通して新製品、新技術をターゲット層に訴求ができたと多くの出展者にご好評をいただいた。

● 商談室の設置

会場内に無料の商談室を設置。個室の空間で従来の展示会より密度の高い商談ができたにご好評をいただいた。

● ストックルーム

ブース内とは別に、多目的にご利用いただけるスペースを提供した。

来場者サービス

より多くの来場者にお越しいただくため、以下のサービスを実施し、来場者の増加を達成。

● [NEW] シャトルバスの運行

来場者の利便性向上のため、りんかい線国際展示場駅⇄東京ビッグサイト(7・8ホール)にて無料シャトルバスを運行し、約3,000名の方にご利用いただいた。

● セミナーの充実

質、量ともに国内最大級のセミナー数を誇り、今年はさらなるセミナー内容の充実を図ったことで、例年以上の動員効果を生み出した。

● 福島県、熊本県 PRブースの充実

熊本地震、東日本大震災の復興支援を目的として、今年も両県にご支援をいただき、両県ならではの自慢の名産品を販売した。熊本県ブースでは、熊本県の営業部長兼しあわせ部長のくまモンも登場し、会場を盛り上げた。

● 実装体験コーナ

実際に部品をはんだ付けして実装し、組み立てて、ロボットキットを完成させるまでの工程を体験できる毎回の人気コーナ。業界団体ならではの企画であり、新人教育にも役立つと来場者の方々にご好評をいただいている。

● インターネット・サービス

各休憩所に Free Wi-Fi のアクセスポイントを設置し、来場者サービスの充実を図った。

● VIPラウンジ

VIP用サービスとして「VIPラウンジ」を展示会場内に設置し、商談率の向上を図った。

主催者テーマ展示～電子回路基板の新たな可能性を探る～

主催者テーマ展示では、先進技術がより身近に感じられ、生活に変化をもたらすユニークな製品、興味が湧いてくる製品が多数展示され、来場者のみならず出展者の方々からも好評いただける展示となった。

■ 基板とグラフィックの融合

海野技研

■ インクジェット方式×銅めっきによるオンデマンドフレキシブル基板

AgIC

■ 透明フレキシブル基板

沖電線

■ Tamashii - 魂

ケイ・ピー・ディ

■ 高精細スクリーン印刷技術

互応化学工業

■ 太陽インキの基板アクセサリ 徳岡大祐の創造

太陽インキ製造

■ 自動車FPC/清戸迫横穴再現織物

日本メクトロン

■ Leather craft ruler 革細工のための補助定規

浜松基板工業

■ AxelGlobe -50機の衛星群による地球観測画像データプラットフォーム

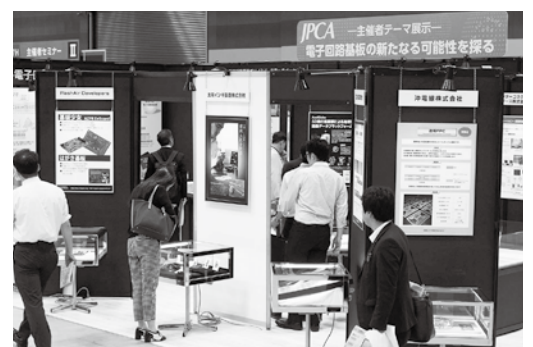
ピーバンドットコム

■ プリント基板ソリューション～技術的強み～

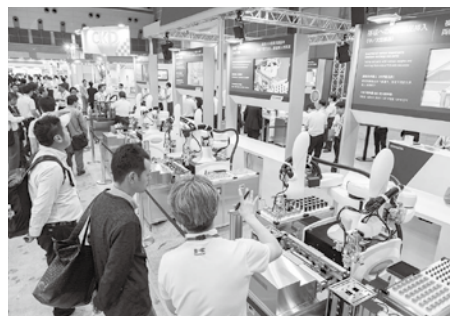
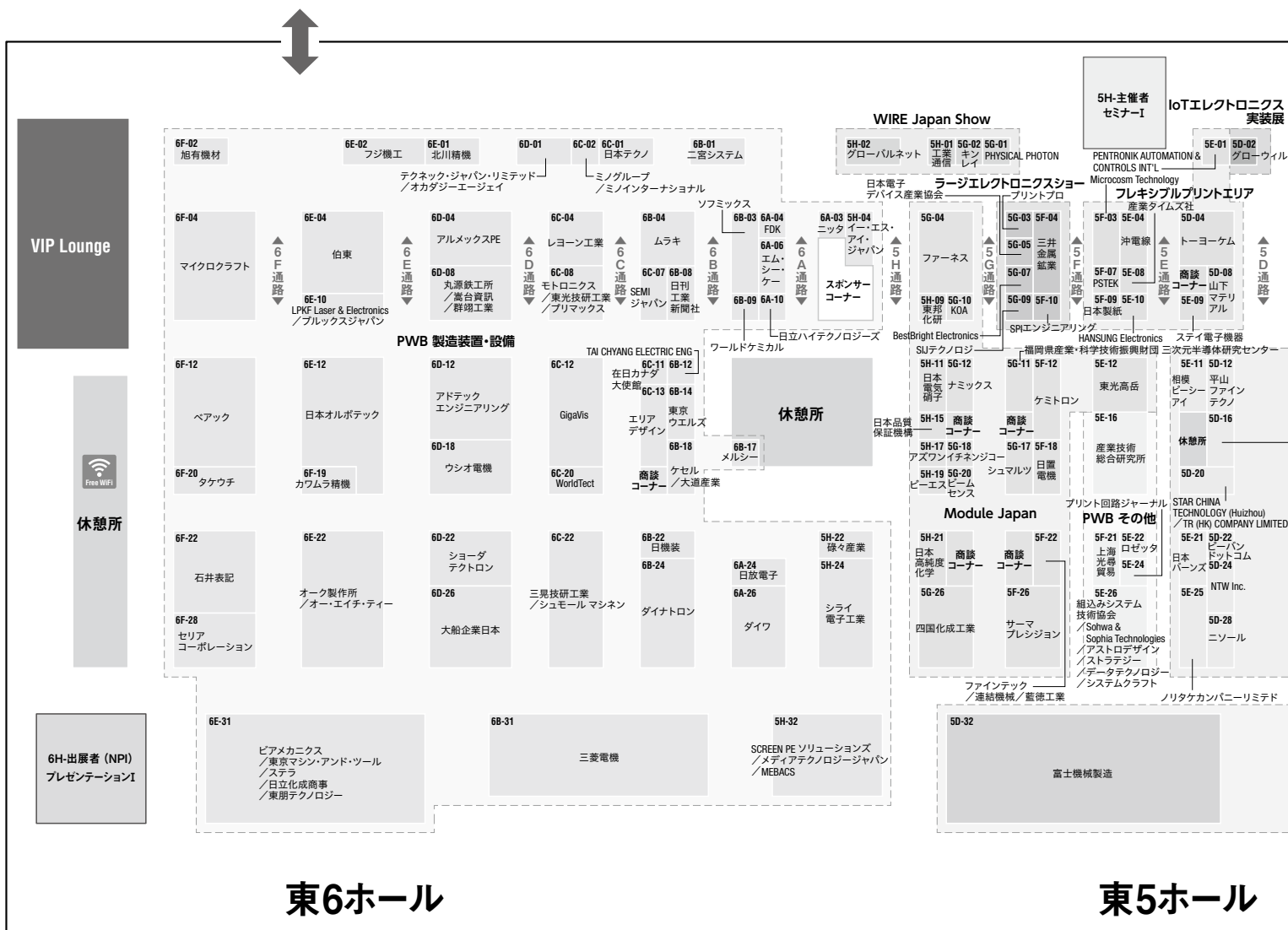
富士通インターコネクテクトテクノロジーズ

■ 基板少女・はがき基板/FlashAirノベルティ基板

FlashAir Developers



会場レイアウト



eX-tech

8A-01	トータス
8A-02	神戸大学大学院理学研究科 木村研究室 / Integral Geometry Science
8A-03	ヴォールイメージング
8A-04	秋田化学工業
8A-06	悟空
8B-01	東北ワンピース
8B-02	いおう化学研究所
8B-03	アテネ

8B-04	Shimada Appli
8B-05	ウェルプラズマ装置営業部
8B-06	メルクバフォーマンスマテリアルズ
8B-07	エンプラス半導体機器
8B-08	並木精密宝石
8B-09	日立パワーソリューションズ
8B-10	岡本工作機械製作所
8B-12	日本板硝子
8B-13	DIC

8B-14	エスベック
8B-16	オルテコーポレーション
8B-17	イープロニクス
8B-18	アルファードデザイン
8C-01	ウェルテストウェハ営業部
8C-03	富士通クオリティ・ラボ
8C-07	藤倉化成
8C-09	アビックヤマダ

アカデミックプラザ

8A-05	電子回路基板技術振興財団
8C-02	エレクトロニクス実装学会 ミッションフェロー
8C-04	群馬大学 大学院 理工学府 知能機械創製部門 白石研究室 /リアライズコンピュータエンジニアリング
8C-06	群馬大学大学院 理工学府 井上研究室
8C-08	群馬工業高等専門学校 機械工学科 材料デザイン研究室
8C-10	京都市産業技術研究所
8C-12	京都市産業技術研究所
8C-14	京都市産業技術研究所
8C-16	京都市産業技術研究所
8D-01	関東学院大学 理工学部 小岩研究室
8D-02	関東学院大学 / 沖エンジニアリング
8D-03	東京大学 日暮研究室
8D-04	関東学院大学 理工学部 小岩研究室 / フォトテクニカ
8D-05	関東学院大学 大学院 工学研究科 物質生命科学専攻 小岩研究室 / 早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 / 早稲田大学 理工学術院
8D-06	神戸大学大学院理学研究科 木村研究室
8D-07	スピンドバイステクノロジーセンター (SDTC) 先端磁気デバイス (佐藤・曾根原) 研究室・中山研究室
8D-08	スピンドバイステクノロジーセンター (SDTC) 中山研究室・ 先端磁気デバイス (佐藤・曾根原) 研究室
8D-09	信州大学 工学部 電子情報システム工学科 先端磁気デバイス (佐藤・曾根原) 研究室
8D-10	国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 電子制御工学科 中山研究室
8D-11	東京大学 生産技術研究所 付加製造科学研究室

8D-12	九州大学 大学院システム生命科学府 ナノ・マイクロ工医学研究室 / 東京大学 日暮研究室 / エクストコム
8D-13	東京大学
8D-14	九州大学大学院システム情報科学研究院情報エレクトロニクス部門 金谷研究室
8D-15	大阪府立大学 大学院工学研究科物質・化学系専攻化学工学分野材料プロセス工学グループ
8D-16	大阪府立大学 大学院 工学研究科 分子認識化学研究グループ / グリーンケム
8E-01	大阪産業技術研究所
8E-02	東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室
8E-03	東京都立産業技術研究センター
8E-04	横浜国立大学大学院 工学研究院 機能発現工学専攻 反応装置工学研究室
8E-05	山口東京理科大学
8E-06	日本大学理工学部 精密機械工学科 マイクロデザイン研究室
8E-07	早稲田大学 情報生産システム研究センター 異研究室
8E-08	東京工芸大学 工学部 電子機械学科 越地研究室
8E-09	大阪大学 産業科学研究所 先端実装材料研究分野
8E-10	鹿児島大学 大学院 理工学研究科機械工学専攻 / 日本機械学会 RC271 研究会
8E-11	同志社大学 理工学部 機械系学科 生産システムデザイン研究室 / 龍谷大学 機械システム工学科 小川研究室
8E-12	明星大学 連携研究センター
8E-13	明治大学理工学部機械工学科計測情報研究室
8E-15	芝浦工業大学 エネルギー物性研究室

3D-MIDパビリオン

7A-47-01	日本モレックス
7A-47-02	エビナ電化工業
7A-47-03	テクノアルファ
7A-47-04	大英エレクトロニクス
7A-47-05	ローム・アンド・ハース電子材料 (ダウ・ケミカルグループ)
7A-47-06	LPKF Laser & Electronics
7A-47-07	富士機械製造
7A-47-08	太陽インキ製造

7A-47-09	パナソニック
7A-47-10	図研
7A-47-11	三共化成
7A-47-12	岩手県工業技術センター
7A-47-13	奥野製薬工業
7A-47-14	マクダーミッド・エンソン
7A-47-15	日本MID協会

スポンサーシップ

約4万人の来場者へ広くアピール頂ける様々なスポンサー特典を用意し、ご活用頂いた。

スポンサープログラムの内容

- 会場フロアマップのブース着色表示
- 電子デバイス産業新聞・インタビュー記事の掲載
- 会場フロアマップ広告
- 基調講演会場内での企業ロゴの掲示
- 会場入口平置き
- 展示会メルマガへ社名掲載
- レセプション会場内で企業ロゴ掲載、社名紹介
- 公式HPへロゴ掲載
- スポンサー専用コーナーでの企業紹介

※スポンサーのグレードにより特典は異なります。

Gold Sponsor	
	
	
	
	
Silver Sponsor	
	
Bronze Sponsor	
	
	

JPCA Show 2017

愛工機器製作所	5A-05
IPCA (インド電子回路工業会)	4G-08
アイン	4H-04
AURONA INDUSTRIES	7G-34
旭有機材	6F-02
アスカエンジニアリング	7B-12
アストロデザイン	5E-26
アズワン	5H-17
Accelad	7G-29
アドテックエンジニアリング	6D-12
アドテックジャパン	7A-04
アルメックスPE	6D-04
EIPC (欧州電子回路協会)	4G-12
イー・エス・アイ・ジャパン	5H-04
ELCINA (インド電子工業会)	4H-11
石井表記	6F-22
石原ケミカル	7A-25
イチネンジコー	5G-18
伊原電子工業	5A-03
イビデン	5C-28
岩手県工業技術センター	7A-47-12
インキューベーション・アライアンス	5A-20
インコム	7D-19
インスベック	7D-14
WECC (世界電子回路業界団体協議会)	4G-14
上村工業	7B-14
ウシオ電機	6D-18
海野技研	7G-47
永旺	5B-17
HKPCA (香港線路板協会)	4G-10
エイト工業	5B-02
AglC	7G-47
エーティージー ルーサー アンド メルツァー	7F-14
エー・ディ・ティ	7G-30
NTW Inc.	5D-24
エヌビーシー	5A-05
エビナ電化工業	7A-47-02
FDK	6A-04
FPCコネク	5B-09
エム・シー・ケー	6A-06
エリアデザイン	6C-13
LED Expo Thailand and PCB Thailand	4G-06
LPKF Laser & Electronics	6E-10
LPKF Laser & Electronics	7A-47-06
エレクトロ・システム	5A-21
オー・エイチ・ティー	6E-22
オーグ製作所	6E-22
オーケープリント	5A-02
大船企業日本	6D-26
オカダジーエージェイ	6D-01
オカダジーエージェイ	7C-38
オキツモ	7B-44
沖電線	5E-04
沖電線	7G-47
奥野製薬工業	7A-47-13
奥野製薬工業	7B-26
ガーディアンジャパン	5A-05
化学工業日報社	7E-21
神奈川県立産業技術総合研究所	7A-42
カネカ	7E-44
カミツ	7D-14
カフムラ精機	6F-19
GigaVis	6C-12
北川精機	6E-01
協栄二葉エンジニアリング	5A-28
協栄プリント技研	7A-22
京写	5C-21
Kingboard Laminates Holdings	5B-01
クアドセプト	7G-30
邦田工業	5A-05
熊本県	7H-40
熊本県物産コーナー	7H-40
組込みシステム技術協会	5E-26
倉敷紡績	5B-22
グローワール	5D-02
Glory Faith (Hong Kong) PCB	5A-12
ケイ・ビー・ディ	7G-47

KPCA (韓国電子回路産業協会)	4H-17
ケセル	6B-18
ケミロン	5F-12
KOA	5G-10
互応化学工業	7A-09
互応化学工業	7G-47
Goal Searchers, Zhuhai	7A-12
国際臭素協議会 BSEF Japan	7A-35
サーマプレジジョン	5F-26
在日カナダ大使館	6C-11
相模ビーシーアイ	5A-05
相模ビーシーアイ	5E-11
サクラクレバス	7F-22
山栄化学	7A-19
三共化成	7A-47-11
産業技術総合研究所	5E-16
産業タイムズ社	5E-08
三晃技研工業	6C-22
三晃技研工業	7C-38
サンヨー工業	4H-10
サンワ化学工業	7A-34
C-INNK	7A-39
CSi Global Alliance	7F-30
シイエムケイ・プロダクツ	5C-12
CPCA (中国電子回路工業協会)	4G-18
シーマ電子	7E-23
JX 金属	7D-44
JT	7F-44
JPCA 書籍ブース	7G-43
JPCA (日本電子回路工業会)	7G-47
J-RAS	7F-24
JCU	7C-04
JADASON Enterprises	7C-38
SHENGYI TECHNOLOGY	7D-26
Shenzhen Hongyuhui Technology	5D-25
SHENZHEN JETWAY ELECTRONICS TECH	5B-18
SHENZHEN JINZHOU PRECISION TECHNOLOGY	7D-10
SHENZHEN SUNTAK CIRCUIT TECHNOLOGY	5B-12
Shenzhen Tengxin Precision Stickies Products	7E-34
Sihui Fuji Electronics Technology	5B-21
シグナス	5C-22
四国化成工業	5G-26
システムクラフト	5E-26
ZHEJIANG HUAZHENG NEW MATERIAL	7G-33
ジャプロ工業	7A-13
上海南亜覆銅箔板	7E-38
上海光尋貿易	5F-21
シュマルツ	5G-17
シュモール マシネン	6C-22
ショーダテクトロン	6D-22
シライ電子工業	5H-24
伸光製作所	4H-04
深圳市正善電子	7G-21
新日本空調	5B-20
SCREEN PE ソリューションズ	5H-32
図研	7A-47-10
Star China Technology (Huizhou)	5D-20
ステイ電子機器	5E-09
ステラ	6E-31
ステラ・コーポレーション	7F-26
ストラテジー	5E-26
Smart e-plating RIS, Sungkyunkwan University	7F-44
ゼファー	5C-26
SEMIジャパン	6C-07
セリアコーポレーション	6F-28
双日プラネット	7D-26
双明通信機製作所	5C-17
Sohwa & Sophia Technologies	5E-26
ソフミックス	6B-03
ソマール	7B-34
嵩台資訊	6D-08
大英エレクトロニクス	7A-47-04
TAI CHYANG ELECTRIC ENG	6B-12
大道産業	6B-18
ダイナロン	6B-24
太陽インキ製造	7A-47-08
太陽インキ製造	7B-04
太陽インキ製造	7G-47
太洋工業	7G-13

ダイワ	6A-26
ダイワ工業	4H-06
台湾港建股份	7D-14
TAESUNG	5A-26
高田工業所	7G-18
タケウチ	6F-20
タツタ電線	7D-04
タムラ製作所	7D-32
千葉県	7A-43
China Circuit Technology (Shantou)	5A-22
中小企業基盤整備機構 関東本部	5A-08
チュールップ	7E-18
群翔工業	6D-08
長興材料工業	7C-10
角田プラン製作所	7A-26
TR (HK) COMPANY LIMITED	5D-20
ティーシーティー・ジャパン	7B-29
TPCA (台湾電路板協会)	4H-13
DMカードジャパン	5A-18
データテクノロジー	5E-26
テクノック・ジャパン・リミテッド	6D-01
テクノアルファ	7A-47-03
テクノプリント	5C-25
電子回路企業年金基金	7G-14
デンソー	5B-04
電波新聞社	7G-16
東海神栄電子工業	5A-05
東京ウエルズ	6B-14
東京応化工業	7H-41
東京化工機	7B-20
東京マシン・アンド・ツール	6E-31
東京マシン・アンド・ツール	7C-38
東光技研工業	6C-08
東光高岳	5E-12
東芝ITコントロールシステム	7G-22
東邦化研	5H-09
東朋テクノロジー	6E-31
東レ・デュボン	7D-38
トーヨーケム	5D-04
トップポイント・ジャパン	7B-38
中島化学産業	7G-34
長野県 産業立地・経営支援課	7A-45
ナミックス	5G-12
ニソール	5D-28
ニッポン工業	7H-33
日刊工業新聞社	6B-08
日機装	6B-22
ニッコー・マテリアルズ	7C-10
ニッタ	6A-03
日放電子	6A-24
日本製紙	5F-09
日本セオン	7A-38
日本電気硝子	5H-11
日本ポリテック	7G-37
日本メクトロン	5C-04
二宮システム	6B-01
日本アグフアマテリアルズ	7A-37
日本エバレット・チャールズ	7F-14
日本MID協会	7A-47-15
日本エレクトロプレイング・エンジニアーズ	7B-37
日本オルボテック	6E-12
日本化学産業	7B-21
日本工業新聞社	7G-42
日本高純度化学	5H-21
日本シイエムケイ	5C-12
日本テクノ	6C-01
日本電産リード	7C-14
日本電子デバイス産業協会	5G-05
日本パーカライジング	7F-34
日本バーンズ	5E-21
日本品質保証機構	5H-15
日本メクトロン	7G-47
日本モレックス	7A-47-01
野田スクリーン	5A-04
ノリタケカンパニーリミテド	5E-25
BAODING LIDA PLASTIC INDUSTRY	5B-11
伯東	6E-04
八光電子工業	5B-03
パナソニック	7A-47-09

パナソニック	7C-34
浜松基板工業	7G-47
HANSUNG Electronics	5E-10
PAN-TEC	7C-38
ビアメカニクス	6E-31
ピーエス	5H-19
ピーバンドットコム	5D-22
ピーバンドットコム	7G-47
ピームセンス	5G-20
日置電機	5F-18
VICTORY GIANT TECHNOLOGY (Huizhou)	5B-08
日立化成	7C-26
日立化成商事	6E-31
日立化成商事	7C-26
日立ハイテクサイエンス	5D-16
日立ハイテクノロジーズ	5D-16
日立ハイテクノロジーズ	6A-10
平山ファインテクノ	5D-12
ヒロセ電機	5B-28
ファーンエス	5G-04
ファインテック	5F-22
和仁貿易	7C-38
フィッシャー・インストルメンツ	7D-22
フェイス	5C-17
福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター	5G-11
福島県	7H-38
福島県物産コーナー	7H-38
福田金属箔粉工業	7H-37
富士機械製造	7A-47-07
フジ精工	6E-02
富士通インターコネクテクトテクノロジーズ	5C-11
富士通インターコネクテクトテクノロジーズ	7G-47
富士回路科技	5C-17
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ	7C-20
富士プリント工業	5C-17
FlashAir Developers	7G-47
ブリマックス	6C-08
プリント回路ジャーナル	5E-24
プリント電子研究所	5B-16
ブルックスジャパン	6E-10
ベアック	6F-12
PENTRONIK AUTOMATION & CONTROLS INT'L	5E-01
マイクロクラフト	6F-04
Microcosm Technology	5F-03
マクダーミッド・エンソン	7A-01
マクダーミッド・エンソン	7A-47-14
松尾産業	7G-23
松定プレジジョン	7E-14
松田産業	7A-44
丸源鉄工所	6D-08
三菱ガス化学	7E-26
三菱電機	6B-31
ミノインターナショナル	6C-02
ミングループ	6C-02
村上電子工学	5B-09
ムラキ	6B-04
村田製作所	7F-17
名東電産	5A-05
メック	7C-22
メディアテクノロジージャパン	5H-32
MEBACS	5H-32
メルシー	6B-17
メルテックス	7B-20
モトロニクス	6C-08
安永	7F-21
山勝電子工業	4H-22
山下マテリアル	5D-08
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	4H-26
Utechzone	7E-22
ユニオン ツール	7C-38
ユニチカ	7G-44
揚州依利安達電子有限公司	5C-22
米沢ダイヤエレクトロニクス	7E-26
ライズエレクトロニクス	5B-01
藍徳工業	5F-22
利昌工業	7F-38
RITAエレクトロニクス	5A-10
YINGTAN JIANGNAN COPPER INDUSTRY	7G-38
Lingbao Hongyu Electronics	7F-31
レヨン工業	6C-04
連結機械	5F-22
ローム・アンド・ハース電子材料(ダウ・ケミカルグループ)	7A-14
ローム・アンド・ハース電子材料(ダウ・ケミカルグループ)	7A-47-05
碌々産業	5H-22

ロセッタ	5E-22
ワールドケミカル	6B-09
WorldText	6C-20
2017 マイクロエレクトロニクスショー	
秋田化学工業	8A-04
アテネ	8B-03
アピックヤマダ	8C-09
アルファードデザイン	8B-18
イープロニクス	8B-17
いおう化学研究所	8B-02
Integral Geometry Science	8A-02
ウエル テストウェア営業部	8C-01
ウエル プラズマ装置営業部	8B-05
ヴェオールイメージング	8A-03
エクストコム	8D-12
エスベック	8B-14
エレクトロニクス実装学会	
エレクトロニクス実装学会 ミッションフェロー	8C-02
エンプラス半導体機器	8B-07
大阪産業技術研究所	8E-01
大阪大学 産業科学研究所 先端実装材料研究分野	8E-09
大阪府立大学 大学院 工学研究科 分子認識化学研究グループ	8D-16
大阪府立大学 大学院 工学研究科 化学工学分野 材料プロセス工学グループ	8D-15
岡本工作機械製作所	8B-10
沖エンジニアリング	8D-02
オルテコ・ボレーション	8B-16
鹿児島大学 大学院 理工学研究科機械工学専攻	8E-10
関東学院大学	8D-02
関東学院大学 大学院 工学研究科 物質生命科学専攻 小岩研究室	8D-05
関東学院大学 理工学部 小岩研究室	8D-01
関東学院大学 理工学部 小岩研究室	8D-04
九州大学大学院システム情報科学研究院情報エレクトロニクス部門 金谷研究室	8D-14
九州大学 大学院システム生命科学府 ナノ・マイクロ医学工学研究室	8D-12
京都市産業技術研究所	8C-10
京都市産業技術研究所	8C-12
京都市産業技術研究所	8C-14
京都市産業技術研究所	8C-16
グリーンケム	8D-16
群馬工業高等専門学校 機械工学科 材料デザイン研究室	8C-08
群馬大学大学院 理工学府 井上研究室	8C-06
群馬大学大学院 理工学府 知能機械創製部門 白石研究室	8C-04
神戸大学大学院理学研究科 木村研究室	8A-02
神戸大学大学院理学研究科 木村研究室	8D-06
悟空	8A-06
芝浦工業大学 エネルギー物性研究室	8E-15
Shimada Appli	8B-04
信州大学 工学部 電子情報システム工学科 先端磁気デバイス(佐藤・曾根原)研究室	8D-09
スピンドバイステクノロジーセンター(SDTC) 先端磁気デバイス(佐藤・曾根原)研究室・中山研究室	8D-07
スピンドバイステクノロジーセンター(SDTC) 中山研究室・先端磁気デバイス(佐藤・曾根原)研究室	8D-08
DIC	8B-13
電子回路基板技術振興財団	8A-05
東京工芸大学 工学部 電子機械学科 越地研究室	8E-08
東京大学	8D-13
東京大学 生産技術研究所 付加製造科学研究室	8D-11
東京大学 日暮研究室	8D-12
東京都立産業技術研究センター	8E-03
同志社大学 理工学部 機械系学科 生産システムデザイン研究室	8E-11
東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室	8E-02
東北ワンピース	8B-01
トータス	8A-01
国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 電子制御工学科 中山研究室	8D-10
並木精密宝石	8B-08
日本板硝子	8B-12
日本機械学会 RC271 研究会	8E-10
日本大学理工学部 精密機械工学科 マイクロデザイン研究室	8E-06
日立パワーソリューションズ	8B-09
フォトテクニカ	8D-04
藤倉化成	8C-07
富士通クオリティ・ラボ	8C-03
明治大学理工学部機械工学科計測情報研究室	8E-13
明星大学 連携研究センター	8E-12
メルクパフォーマンスマテリアルズ	8B-06
山口東京理科大学	8E-05

横浜国立大学大学院 工学研究院 機能発現工学専攻 反応装置工学研究室	8E-04
リアライズコンピュータエンジニアリング	8C-04
龍谷大学 機械システム工学部 小川研究室	8E-11
早稲田大学 情報生産システム研究センター 異研究室	8E-07
早稲田大学 ナノ・ライブ創新研究機構	8D-05
早稲田大学 理工学術院	8D-05

JISSO PROTEC 2017

アユミ工業	4F-09
アルファードデザイン	4E-04
アルファエレクトロニクス	4H-01
いけうち	4B-22
エイテックテクトロン	4D-14
エイワ機工	4G-01
エーアイテック	4F-28
エー・エス・エム・アクセプリー・テクノロジー	4B-04
奥原電気	4D-12
オリジン電気	4G-09
化研テック	4B-24
川崎重工業	4A-24
Gichoビジネスコミュニケーションズ	4F-12
コーンテクノロジ	4E-24
サヤカ	4F-04
山陽精工	4G-04
CKD	4A-16
ジャパンコーヨン	4E-24
ジャパンユニックス	4C-20
JARA (日本ロボット工業会)	4D-01
JUKI	4F-32
昭立電気工業	4D-20
シンアベックス	4C-02
セイテック	4E-13
千住金属工業	4C-24
大洋電機産業	4E-10
タカヤ	4F-24
竹内精工	4H-03
竹田印刷	4G-23
タムラ製作所	4A-04
テクノアルファ	4G-22
日本スベリア社	4G-02
日本ミルテック	4C-14
日本溶接協会	4B-14
パーミジャパン	4G-26
ハイウイン	4D-04
パソコン	4F-13
白光	4B-14
パナソニック プロセスオートメーション事業部	5A-32
ファナック	4C-04
富士機械製造	5D-32
プロセス・ラボ・ミクロン	4G-23
ヘラーインダストリーズ	4G-03
マイクロモジュールテクノロジー	4H-07
マルコム	4F-19
三木プリー	4E-28
武蔵エンジニアリング	4A-01
ヤマハ発動機	4B-32
ヤマハファインテック	4B-26
ユニテック	4E-20
ユニテックジャパン	4E-02

ラージエレクトロニクスショー2017

SIJテクノロジー	5G-09
SPIエンジニアリング	5F-10
PSTEK	5F-07
プリントプロ	5G-03
BestBright Electronics	5G-07
三井金属鉱業	5F-04

WIRE Japan Show 2017

キンレイ	5G-02
グローバルネット	5H-02
工業通信	5H-01
PHYSICAL PHOTON	5G-01

基調講演

有料

VIP無料

●聴講者数：全15セッション 2,947名(前回実績：1,999名)

6月7日(水)	10:30 11:15	 IoT革命は世界バトルに突入 ～電子デバイスに一大インパクト～ 泉谷 渉 (株)産業タイムズ社 代表取締役社長
	11:30 12:15	 ファナックが考えるIoT時代に対応したこれからのものづくり 稲葉 清典 ファナック(株) 取締役専務執行役員
	13:00 14:00	 フラットパネルから見たスマートフォン業界の行方 中根 康夫 みずほ証券(株) エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ/シニアアナリスト
	14:15 15:00	 さらなる成長に向けた戦略 江田 麻季子 インテル(株) 代表取締役社長
	15:15 16:00	 パッチ型脳波センサの開発と社会実装 ～ブレインIoTで切り拓く未来～ 関谷 毅 大阪大学 産業科学研究所 教授
6月8日(木)	10:30 11:15	 IoTとモバイルブロードバンドの世界を拓げる5G 尾上 誠哉 (株)NTTドコモ R&Dイノベーション本部 取締役常務執行役員(CTO)
	11:30 12:15	 自動運転の進化と社会へ与えるインパクト 鯉淵 健 トヨタ自動車(株) 先進技術開発カンパニー 常務理事
	13:00 13:45	 サプライチェーンに於けるビッグデータ・アナリティクス 清野 薩夫 日本アイ・ビー・エム(株) IBM システムズ
	14:00 14:45	 世界に誇る日本の光学 ～基礎から最新技術まで～ 大曾根 康裕 (株)シグマ 商品企画部 部長
	15:00 15:45	 未来を拓く事業構想 田中 里沙 事業構想大学院大学 学長 宣伝会議取締役
6月9日(金)	10:30 11:15	 ADAS/自動運転の最新動向と2030年の市場展望 ～大変革期を迎える自動車産業～ 池山 智也 (株)矢野経済研究所 インダストリアルテクノロジーユニット 自動車産業グループ 主任研究員
	11:30 12:15	 人工知能(AI)の最新動向と富士通のAI技術Zinraiのご紹介 原 裕貴 富士通(株) 執行役員
	13:00 13:45	 印刷技術でイノベーションを起こす ～有機ELディスプレイの新潮流～ 竹澤 浩義 (株)JOLED 常務執行役員 事業戦略部門長
	14:00 14:45	 オープンIoTが創る新しい社会 坂村 健 東洋大学 情報連携学部 学部長
	15:00 15:45	 SEMI/JPCAコラボレーション More than Moore:フレキシブルエレクトロニクスとデジタルヘルス 小柴 満信 JSR(株) 代表取締役社長













JIEP 最先端実装技術シンポジウム 有料

●聴講者数：1,543名 (前回実績：622名)

6月7日(水)	7A1 グローバル化に対応した知的財産戦略 座長：田畑 晴夫		7B1 IoT技術を支える電磁環境・EMC設計技術 座長：越地 福朗	
	10:40 11:35	実装技術分野の明細書の書き方  荒 則彦 特許業務法人 志賀国際特許事務所	10:40 11:35	IoTとEMC  櫻井 秋久 日本アイ・ピー・エム(株) 研究開発 IBM ディスティングイッシュト・エンジニア
	11:35 12:30	海外事業展開と知財戦略 -知財紛争回避と技術漏洩防止のために-  渡辺 浩司 坂本国際特許事務所 所長代理	11:35 12:30	IoT時代のEMCを考慮したプリント配線板設計  原田 高志 (株)トーキンEMCエンジニアリング EMCテクニカルセンター 技師長
	7A2 パワーデバイス技術の市場用途と展望 座長：渡邊 裕彦		7B2 システムインテグレーション、IoT時代を担う実装技術の現状と課題、ソリューションの提案 座長：西田 秀行	
	13:35 14:30	カーエレクトロニクスを牽引する半導体技術  藤本 裕 (株)デンソー 基礎研究 3部 担当部長	13:35 14:30	Smart IoTに向けた先進実装技術  堀部 晃啓 日本アイ・ピー・エム(株) 東京基礎研究所 課長
	14:30 15:25	何でも掴むロボットハンドの使い道 -パワーエレクトロニクス編-  清水 俊彦 神戸市立工業高等専門学校 機械工学科 准教授	14:30 15:25	情報処理装置の大容量化に向けた回路実装技術  中條 徳男 (株)日立製作所 研究開発グループ 生産イノベーションセンター 主任研究員
15:25 16:20	SiCパワー素子の電力変換器応用の現状とその将来展望  山口 浩 (国研) 産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター 副研究センター長	15:25 16:20	液浸スーパーコンピュータ ZettaScalerシリーズの実装技術  鳥居 淳 (株)ExaScaler 研究開発部 部長・CTO	

6月8日(木)	8A1 自動運転 座長：大竹 精一郎		8B1 次世代エレクトロニクス機器対応 FO-WLP技術 座長：和嶋 元世	
	9:45 10:40	自動運転車の開発動向と実用化に向けた技術開発状況  青木 啓二 先進モビリティ(株) 代表取締役	9:45 10:40	FO-WLPは次世代モバイル機器実装の主役になり得るか？  西尾 俊彦 (株)SBRテクノロジー 本社 代表取締役
	10:40 11:35	自動走行時代の車載半導体とその実装技術  村松 菊男 e-SYNC(株) 代表取締役	10:40 11:35	さらなる高密度化を意識した半導体パッケージ技術の開発動向  谷口 文彦 (株)ジェイデバイス 開発センター 実装開発部 部長
	11:35 12:30	自動運転技術の動向とシステムアーキテクチャの今後  坂上 義秋 (株)本田技術研究所 R&D センター-X 開発戦略室 上席研究員	11:35 12:30	Fan-out Panel Level Packageに内蔵する部品装着技術  楠 一弘 富士機械製造(株) ロボットソリューション事業本部 第一機械技術部 技術企画課 シニアリーダー
	8A2 自動車パワートレインシステム電動化(EV・FCV・HV)と実装技術の課題 座長：三宅 敏広		8B2 プリントブル技術と材料技術のこれから 座長：土門 孝彰	
	13:35 14:30	EVの電源系・駆動系における制御システムのシミュレーション駆動設計開発  白石 洋一 群馬大学 理工学研究院 知能機械創製部門 准教授	13:35 14:30	有機両極性半導体の開発と自己組織化分子薄膜を用いたキャリア種制御  中野 正浩 (国研) 理化学研究所 創発物性科学研究センター(CEMS) 創発分子機能研究グループ 基礎科学特別研究員
14:30 15:25	燃料電池車(FCV)の開発状況と普及拡大に向けた動向  大仲 英巳 技術研究組合FC-Cubic 専務理事	14:30 15:25	プリントドエレクトロニクスによるフレキシブルIoTデバイスの開発  鎌田 俊英 (国研) 産業技術総合研究所 フレキシブルエレクトロニクス研究センター 研究センター長	
15:25 16:20	環境対応車向けパワーモジュールにおけるはんだ接合部の設計技術  門口 卓矢 トヨタ自動車(株) パワートレインカンパニー エレクトロニクス生技部 主幹	15:25 16:20	コムラテックの技術紹介と印刷法による有機ELの開発取り組みについて  浦野 雅明 (株)コムラテック 次世代ものづくりセンター	

6月9日(金)	9A1 エレクトロニクスにおける樹脂の特性と高機能化 座長：小日向 茂		9B1 IoTを支えるセンサー技術 座長：齊藤 雅之	
	9:45 10:40	ビスマレイミド系高耐熱性樹脂の材料設計  大塚 恵子 (地独) 大阪産業技術研究所 研究主幹 兼 有機材料研究部 熱硬化性樹脂研究室長	9:45 10:40	道路インフラモニタリングシステムとセンサ端末実装技術の開発  原田 武 技術研究組合 NMEMS技術研究機構、(一財)マイクロマシンセンター 研究開発部長 主幹研究員
	10:40 11:35	エポキシ樹脂の構造と物性および開発の方向性  中西 政隆 日本化薬(株) 機能化学品研究所	10:40 11:35	“アバウト”に動体をとらえて“それとなく”見守る人感センサ技術  野村 健一 (国研) 産業技術総合研究所 フレキシブルエレクトロニクス研究センター 主任研究員
	11:35 12:30	分野横断的な応用を可能にする低温大気圧ハイブリッド接合技術  重藤 暁津 (国研) 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 表面・接着科学グループ 主幹研究員	11:35 12:30	トリリオンセンサ -見えない価値の可視化技術-  寺崎 正 (国研) 産業技術総合研究所 製造技術研究部門 トリリオンセンサ研究グループ 研究グループ長
	9A2 モジュールエレクトロニクスの今後の進展 座長：土門 孝彰		9B2 半導体とMEMS、センサの融合 座長：白石 洋一	
	13:35 14:30	「トリリオンノード・エンジン」が創るオープンイノベーション・プラットフォーム-みんなで作るIoT/CPSの未来-  桜井 貴康 東京大学 生産技術研究所 教授	13:35 14:30	次世代コンピュータの中核ニューロモフィックチップの進展  内場 文男 日本大学 理工学部 精密機械工学科 教授
14:30 15:25	モジュールエレクトロニクスを支えるCAD技術と標準化  松澤 浩彦 (株)図研 EDA事業部 EL開発部 シニア・パートナー	14:30 15:25	マイクロシステムを用いた医療機器・ヘルスケア機器の開発  芳賀 洋一 東北大学 大学院医学工学研究科/大学院工学研究科 教授	
15:25 16:20	モジュール構造の進展と先進配線板のあるべき姿を探る  本多 進 (特非) サーキットネットワーク 理事	15:25 16:20	窒化アルミニウム系圧電薄膜の開発  上原 雅人 (国研) 産業技術総合研究所 製造技術研究部門 主任研究員	



出展者セミナー

1) 出展者 (NPI) プレゼンテーション

- 日 時: 6月7日(水)～9日(金) ●聴講料: 無料
- 会場: 6H-出展者(NPI)会場I・7H-出展者(NPI)会場II ●聴講者数: 2,204名(前回実績: 1,892名)

●発表出展会社

(50音順)

アトテックジャパン(株)/アユミ工業(株)/(株)石井表記/上村工業(株)/ウシオ電機(株)/LPKF Laser & Electronics(株)/(株)オーク製作所/沖電線(株)/奥野製薬工業(株)/川崎重工工業(株)/KOA(株)/山陽精工(株)/(株)JCU/シュマルツ(株)/(株)SCREEN アドバンストシステムソリューションズ(株)ステラ・コーポレーション/(株)セリアコーポレーション/千住金属工業(株)/広東生益科技有限公司/ダイナトロン(株)/テクネック・ジャパン・リミテッド/テクノアルファ(株)/(株)東光高岳/(株)ニソール/日本エレクトロプレイング・エンジニアーズ(株)/日本オルボテック(株)/日本化学産業(株)/日本パーカラライジング(株)/パナソニック(株)/日置電機(株)/日立化成(株)/ファナック(株)/公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター/富士通インターコネクトテクノロジーズ(株)/(株)プロセス・ラボ・ミクロン/(株)プリントプロ/ユニオン ツール(株)/(株)ロゼッタ

2) 3D-MIDセミナー／大使館・自治体セミナー

- 日 時: 6月7日(水)～9日(金) ●聴講料: 無料
- 会場: 7H-3D-MIDパビリオン ●聴講者数: 505名(前回実績: 474名)

●3D-MIDセミナー発表出展会社

(50音順)

岩手県工業技術センター/LPKF Laser & Electronics(株)/三共化成(株)/(株)関研/大英エレクトロニクス(株)/太陽インキ製造(株)/日本MID協会/マクダーミッド・エンソン

●大使館・自治体セミナー発表会社

(50音順)

神奈川県産業技術総合研究所/在日カナダ大使館/千葉県/データロボット

3) PROTECセミナー

- 日 時: 6月7日(水)～9日(金) ●聴講料: 無料
- 会場: 5H-PROTEC会場 ●聴講者数: 1,007名(前回実績: 700名)

JISSO PROTEC 特別講演

6月7日(水)・8日(木) 11:00 - 12:00

2017年度版 JEITA 実装技術ロードマップより 実装設備の概要と今後の展開

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ(株) 技術統括部 主任技師

JEITA jisso 技術ロードマップ 専門委員会 WG6 主査 井上 高宏

●発表出展会社

(50音順)

JUKIオートメーションシステムズ(株)/千住金属工業(株)/パナソニック(株)/パナソニック スマートファクトリーソリューションズ(株)/富士機械製造(株)/武蔵エンジニアリング(株)/ヤマハ発動機(株)

4) アカデミックプラザ

- 日 時: 6月7日(水)～9日(金) ●聴講料: 無料
- 会場: 8H-アカデミックプラザ ●聴講者数: 772名(前回実績: 540名)

●アカデミックプラザ参加大学・研究機関等一覧

(50音順)

大阪産業技術研究所/大阪大学/大阪大学大学院/大阪大学レーザーエネルギー学研究中心/大阪府立大学/鹿児島大学/関東学院大学/九州大学/(地独)京都市産業技術研究所/群馬工業高等専門学校/群馬大学大学院/神戸大学大学院/芝浦工業大学/信州大学/東京大学大学院/東京工芸大学大学院/東京工芸大学/(地独)東京都立産業技術研究センター/東京理科大学/同志社大学/長野工業高等専門学校/日本大学/明星大学/山口東京理科大学/横浜国立大学/早稲田大学

5) 2017 アカデミックプラザ受賞式

アカデミックプラザで発表された研究発表論文の中から、JIEP 展示会事業委員会(白石委員長: 群馬大学大学院 理工学府 知能機械創製部門 准教授)で優秀な論文内容が選考され、アカデミックプラザ賞受賞者が決定した。

■ 多層基板を用いた SiC パワーモジュールのスイッチングサージに関する一検討 -モジュール基板の寄生成分によるスイッチングサージ解析-	大阪大学 舟木研究室 福永 崇平/舟木 剛
■ SMAを駆動源とした歩行型MEMSマイクロロボットの開発	日本大学 内海 裕人/河村 慧史/田中 泰介/仲田 友也/田中 大介/ 高藤 美泉/齊藤 健/内木場 文男
■ 次世代MEMSデバイスのための低熱膨張 Fe-Ni合金めっきプロセスKEEPNEX®の開発	地方独立行政法人京都市産業技術研究所 永山 富男/山本 貴代/中村 俊博
■ 新方式半導体ソケットのための電気接触 ピン用ゴムコア一通電ボール開発	東京大学大学院 新領域創成科学研究科 人間環境学専攻 鳥居 徹
■ 半円台形不平衡ダイポールアンテナの折り曲げによる小形化の検討	東京工芸大学大学院 島崎 勇登/越地 福朗 東京理科大学 越地 耕二
アカデミックプラザ5年連続継続賞 (地独)東京都立産業技術研究センター 開発第三部 情報技術グループ/大阪府立大学 工学研究科 物質・化学系専攻 応用化学分野 分子認識化学研究グループ/群馬大学 井上研究室/ 神戸大学 木村研究室/長野工業高等専門学校 中山研究室/早稲田大学 巽研究室	

標準化セミナー 無料

●聴講者数：602名（前回実績：763名）

6月7日(水)	10:30-11:00	JPCA認定制度PWBコンサルタントおよびPWBインストラクタ試験のご紹介	榎場 正男 (株)カヤバオフィス
	11:30-12:30	部品内蔵モジュールの追加で統合規格を充実! 電子回路基板規格 (UB01) 第3版の紹介	浦西 泰弘 JPCA 統合規格部会
	14:10-17:00	2019年完全実施IEC62368-1に向けて各国固有安全規格から国際安全規格化の動き& UL Forum 榎場 正男、酒井 和英、金野 郁郎 (株)カヤバオフィス、(株)UL Japan	
6月8日(木)	13:00-14:00	部品内蔵モジュールの追加で統合規格を充実! 電子回路基板規格 (UB01) 第3版の紹介	浦西 泰弘 JPCA 統合規格部会
	14:30-15:30	自動車電装用及びパワーデバイス用高放熱性電子回路基板規格について	米村 直己 デンカ(株) 主幹研究員
6月9日(金)	10:30-11:30	部品内蔵モジュールの追加で統合規格を充実! 電子回路基板規格 (UB01) 第3版の紹介	浦西 泰弘 JPCA 統合規格部会
	13:30-14:00	JPCA認定制度PWBコンサルタントおよびPWBインストラクタ試験のご紹介	榎場 正男 (株)カヤバオフィス
	14:15-16:15	光電子回路実装標準化セミナー JPCA光電子回路標準化推進委員会/栃木県産業技術センター/技術研究組合光電子融合基盤技術研究所/US Conec Ltd.	中野 義明/伊藤 日出男/蔵田 和彦/佐武 俊明

主催者セミナー 無料

●聴講者数：

ダントツものづくりセミナー 1,115名（前回実績：962名）
 ぷりんとばんじゅくセミナー 307名（前回実績：278名）
 JPCAめっき表面処理セミナー 264名（前回実績：333名）
 JPCA設計セミナー 108名（前回実績：287名）

ダントツものづくりセミナー

6月7日(水)	ダントツものづくりセミナー 特別講演		
	13:00-13:50	トヨタ式現場管理「ものづくり日本再生のための7つのカイゼン」 田中 正知 ものづくり大学名誉教授/元トヨタ生産調査部部長 (株)Jコスト研究所 代表取締役	
	ものづくり人財生産性向上セッション		
	13:50-14:20	超高効率電子回路生産システム (E-ESMAP) 研究会活動紹介 山本 治彦 超高効率電子回路生産システム研究会 JPCA 副会長/ E-ESMAP 研究会代表幹事	
	14:20-15:00	ものづくり管理会計「企業経営の『良い設計・良い流れ』」 柘 紫乃 山形大学 大学院理工学研究科MOT 専攻 工学部システム創成工学科 准教授	
15:00-15:40	実践感動経営「儲かる経営とものづくり人財の育て方」 本田 峯生 経営・人財育成アドバイザー		
15:40-16:20	現場改善の実態「生産革新の新しい方向性」 柳田 俊明 (株)岩城生産システム研究所 コンサルタント		
6月8日(木)	ダントツものづくりセミナー 特別講演		
	13:00-13:50	IoTソリューション開発取り組みのご紹介 佐藤 武史 (株)村田製作所 モジュール事業本部 IoT 統括部 IoT 事業推進部 部長	
	ものづくりIoT導入事例セッション		
	13:50-14:20	超高効率電子回路生産システム (E-ESMAP) 研究会活動紹介 山本 治彦 超高効率電子回路生産システム研究会 JPCA 副会長/ E-ESMAP 研究会代表幹事	
	14:20-15:00	IoTを活用した生産設備の知能化による生産性向上 高見 真司 オムロン(株) 綾部工場 製造部 デバイス課 課長	
15:00-15:40	IoTで工場見える化 西村 威彦 富士通(株)		
15:40-16:20	IoTとロボット導入 西山 強志 (株)デンソーウェーブ		
6月9日(金)	ダントツものづくりセミナー 特別講演		
	13:00-13:50	IoT時代の設備ライフサイクル管理 高田 祥三 早稲田大学 創造理工学部経営システム工学科 教授	
	電子回路スマートものづくりセッション		
	13:50-14:20	超高効率電子回路生産システム (E-ESMAP) 研究会活動紹介 山本 治彦 超高効率電子回路生産システム研究会 JPCA 副会長/ E-ESMAP 研究会代表幹事	
	14:20-15:00	中小・中堅電子回路製造 IoT 導入に向けた自動化・ロボット化の考察 小島 史夫 早稲田大学 客員教授/(株)デンソー ダントツ工場推進部 テクニカルエキスパート 工学博士	
15:00-15:40	中小・中堅電子回路現場で活用できるIoTツール 石田 裕三 野村総合研究所 上級アプリケーションエンジニア		
15:40-16:20	中小・中堅電子回路製造現場のIoTスマートメンテナンス 小林 洋 日本設備学会・スマートメンテナンス研究会 主査/日産自動車(株) 車両生産技術本部 プラント・メンテナンスエンジニアリング部 エキスパートリーダー		

主催者セミナー 無料

ぷりんとばんじゅくセミナー

6月7日(水)	10:30-12:00	ぷりんと配線板全般について“ぷりんとばんじゅくI”をもとに基礎から解決 Part 1	小林 正 小林技術事務所
	13:00-14:30	ぷりんと配線板設計について“ぷりんとばんじゅくII”をもとに基礎から解決	田中 弘文 (株)オンテック
	15:00-16:30	物作りの競争力を強める品質管理	長谷川 堅一 PWBコンサルタント
6月8日(木)	10:30-12:00	ぷりんと配線板全般について“ぷりんとばんじゅくI”をもとに基礎から解決 Part 2	小林 正 小林技術事務所
6月9日(金)	10:30-12:00	“ぷりんとばんじゅくV”をもとに、半導体のパッケージング、電子部品などの電子回路実装について解説	榎場 正男 (株)カヤバオフィス / PWBコンサルタント

JPCAめっき表面処理セミナー

6月8日(木)	13:00-14:00	(株)アズマのQCD	内海 匡史 (株)アズマ 製造部 主任
	14:00-15:00	ダイレクト金めっきとその他表面処理のご紹介	奥富 弘樹 栄電子工業(株) 技術部 課長
	15:00-16:00	めっき不良モードとトラブルシューティング	工藤 淳司 ブラメックス(株) 技術部 部長

主催者セミナー 有料

JPCA設計セミナー

6月7日(水)	13:00-14:30	攻略! DDR4 プロジェクト事例 Part 1	須藤 俊夫 DDR4 実証実験プロジェクト 芝浦工業大学名誉教授 IEEE Fellow
	14:45-15:30	DDR4 規格の仕様と設計上の注意	前田 真一 KEI Systems, Inc. 代表
6月8日(木)	13:00-14:30	攻略! DDR4 プロジェクト事例 Part 2	益子 行雄 DDR4 実証実験プロジェクト プロジェクトリーダー
	14:45-15:30	ザイリンクスの高速・広帯域伝送ソリューション	中根 正雄 ザイリンクス(株) エンジニアリング本部 シニア I/O スペシャリスト
	15:40-16:25	高速メモリー時代における設計解析ソリューション	森谷 卓矢 日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 フィールドエンジニアリング&サービス本部 Silicon-Package-Board アプリケーション・エンジニア
6月9日(金)	13:00-14:30	攻略! DDR4 プロジェクト事例 Part 3	前田 真一 DDR4 実証実験プロジェクト KEI Systems, Inc. 代表
	14:45-15:30	DDR4システムのデバッグ検証におけるキーサイトの最新ソリューション	陰浦 俊則 キーサイト・テクノロジー(同) ソリューションエンジニアリング本部 アプリケーションエンジニア
	15:40-16:25	IBISモデルの基本と推奨解析フロー	藤森 省吾 富士通アドバンスドテクノロジー(株) 複合回路技術統括部 電気シミュレーション技術開発部 マネージャー(JEITA / ECセンター IBIS 推進WGリーダー)



共催セミナー/実装体験コーナ

●半導体・オブ・ザ・イヤー2017

6月7日(水)	14:00 - 15:00	半導体・オブ・ザ・イヤー2017 受賞製品・技術発表	
	15:00 - 17:00	受賞各社による製品プレゼンテーション	
	半導体デバイス部門	グランプリ	エヌビディア 手のひらサイズで高いエネルギー効率の自動運転車向け AI コンピュータ 「NVIDIA DRIVE PX 2 AI コンピューティング・プラットフォーム」
		優秀賞	ソニー(株) 「DRAM を積層した3層構造のスマートフォン向けCMOS イメージセンサー」 トレックス・セミコンダクター(株) 高速過渡応答 HiSAT-COT 制御を採用したDC/DC コンバータ「XC9273 シリーズ」
	半導体製造装置部門	グランプリ	キヤノン(株) KrF エキシマレーザーステップパー「FPA-3030EX6」
		優秀賞	SPP テクノロジーズ(株) シリコン深掘り装置「ASE-Proxion (エーエスイー プロクシオン)」 (株)SCREEN セミコンダクターソリューションズ 世界最高水準の生産性実現した枚葉式洗浄装置「SU-3300」
	半導体用電子材料部門	グランプリ	宇部興産(株)、山形大学 印刷有機集積回路に適用可能なN型有機半導体
		優秀賞	DIC(株) 半導体製造の次世代プロセス「ナノインプリント技術」に対応したレジスト用樹脂

●実装体験コーナ **無料** **一部企業無料** ●体験者数：46名(前回実績：42名)

ロボットキットを使った部品実装を体験いただけるコーナを設置。

会期3日間共通	11:00 - 12:30	<h3>オルゴールごま</h3> <p>コマを回すとその遠心力により電源スイッチが入り4色の発光ダイオードが点灯！ 加え、メロディICの音が流れます。</p> <p>費用 一般：1,000円 出展企業/JPCA会員企業：無料</p>	<h3>光センサー・おちないロボ</h3> <p>2つのセンサーで床を探りながら走行するロボット！落ちそうになっても光センサーが すばやく反応してバックし、方向転換する賢いロボットです。</p> <p>費用 2,000円</p>
	14:00 - 15:30		

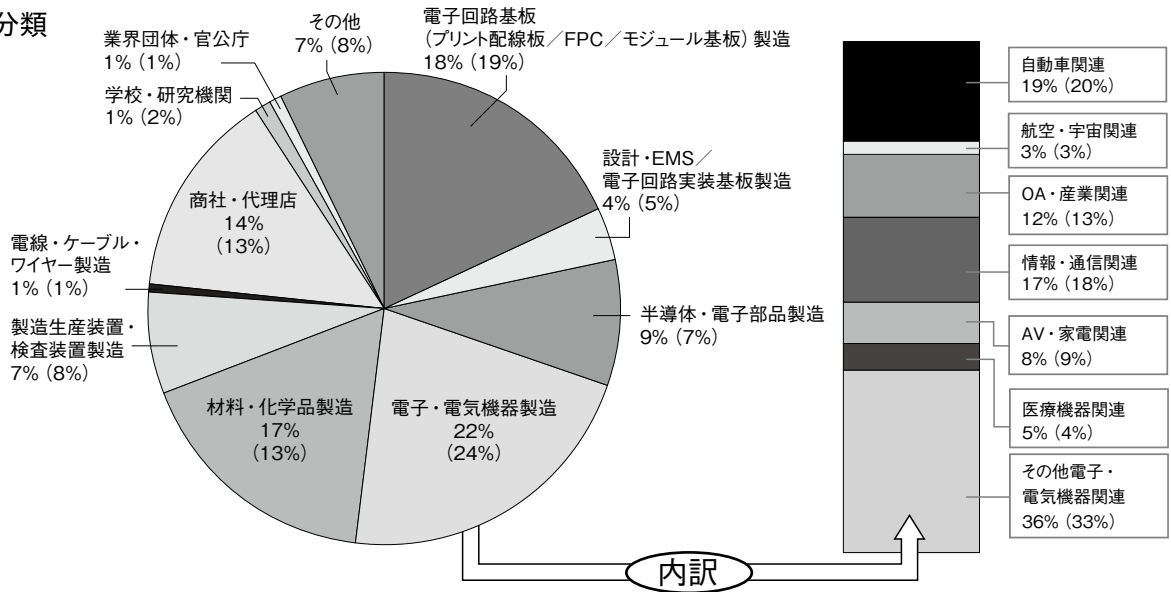


来場者分析

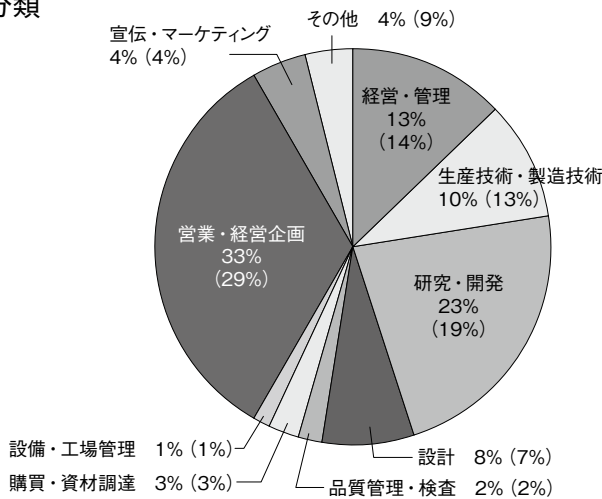
() 前回数値

全展示会実績

①来場者の業種分類

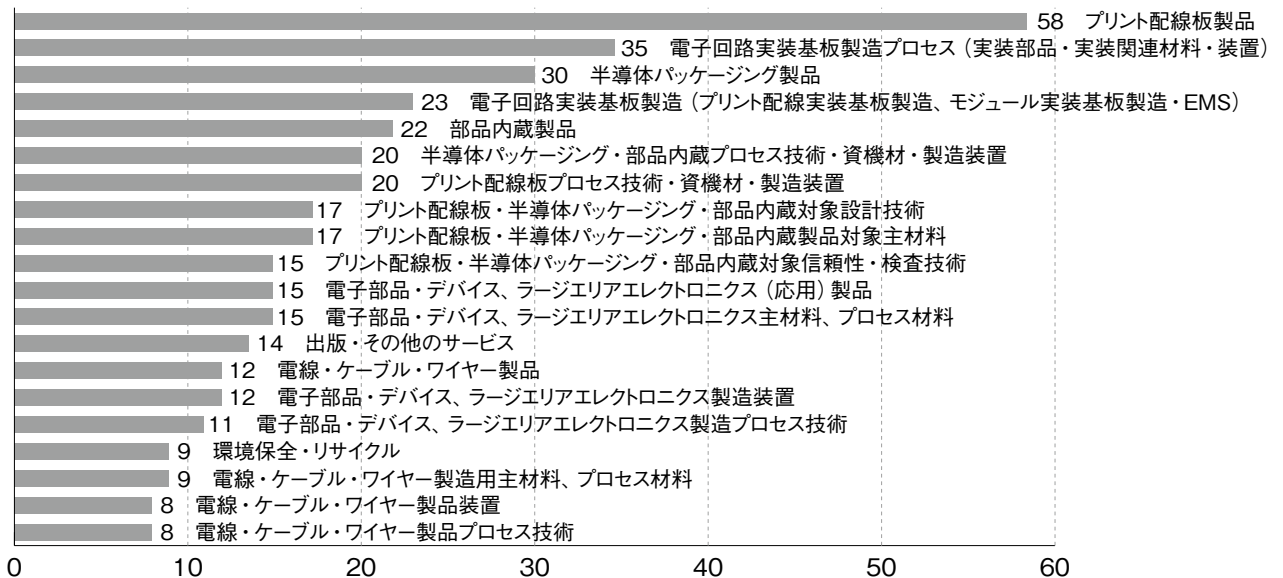


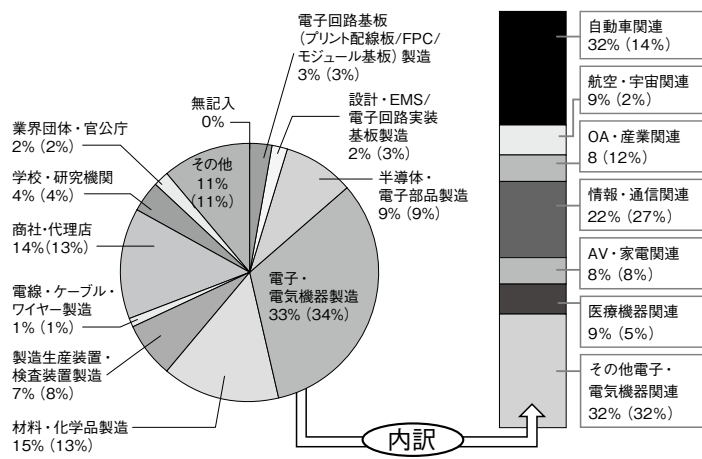
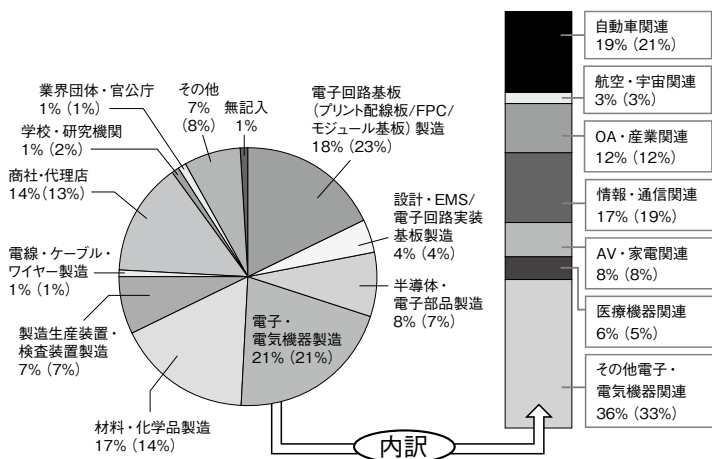
②来場者の職種分類



電子機器に関わる幅広い業種の方が来場している。また、経営、製造技術、R&D、設計など、ものづくりに関わる来場者が半数を超える。

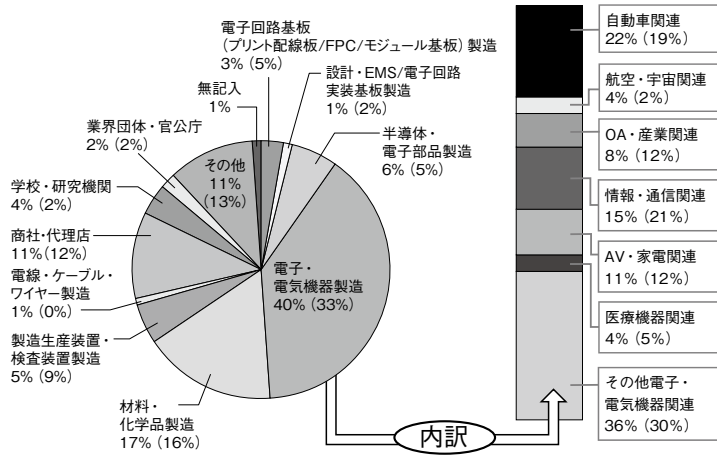
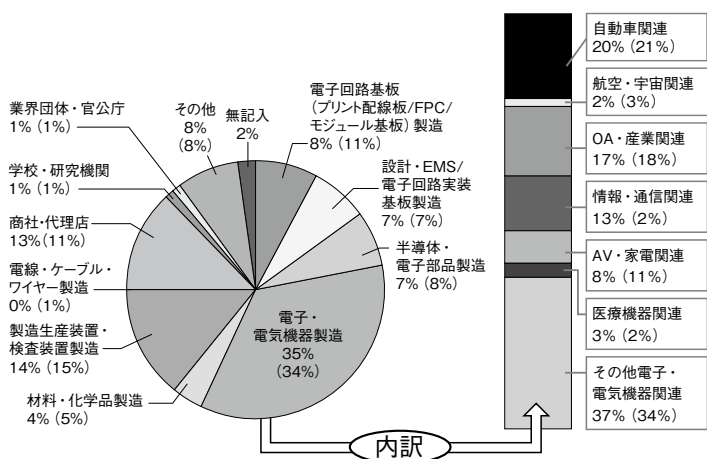
③来場者が関心のある製品分類 ※複数回答



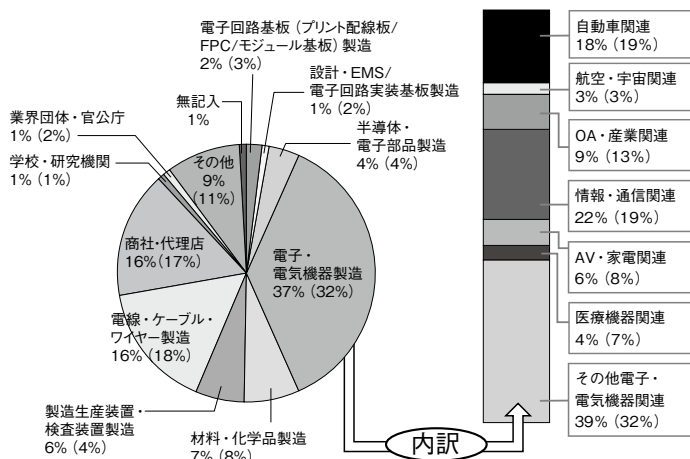


JISSO PROTEC 2017

ラージエレクトロニクスショー2017



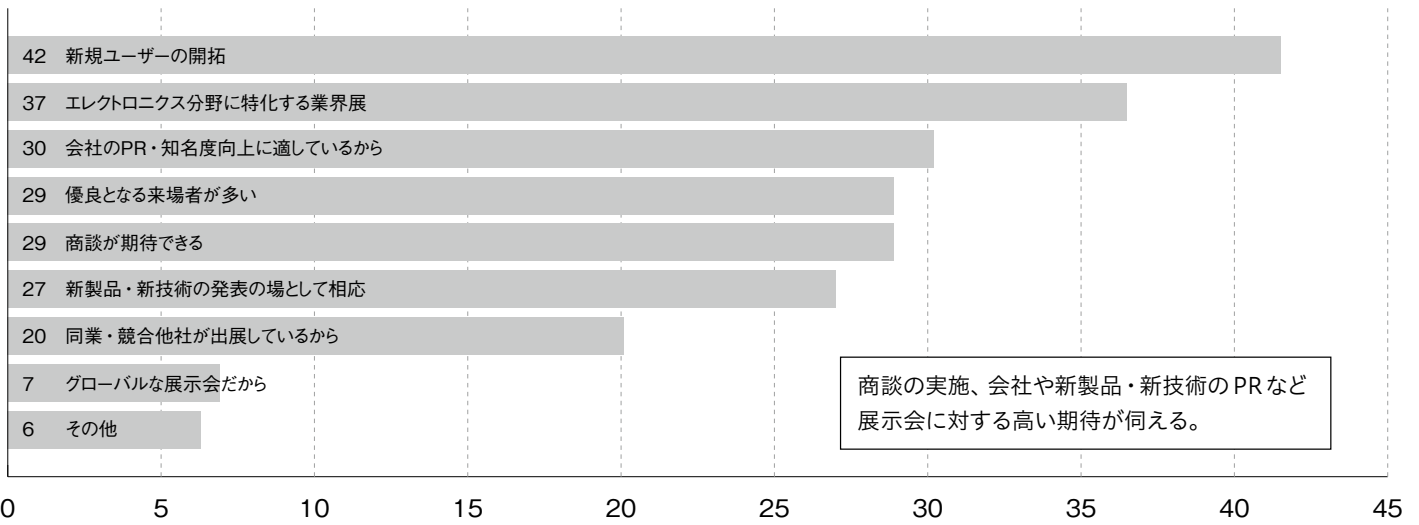
WIRE Japan Show 2017



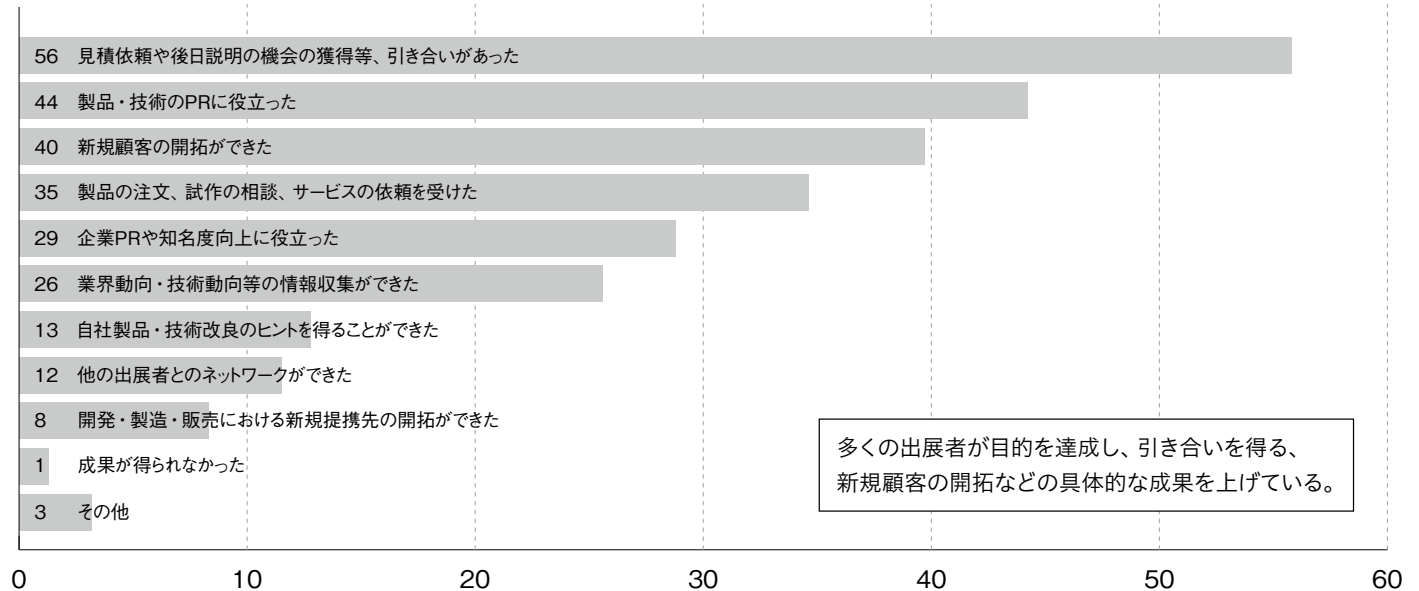


出展者アンケート

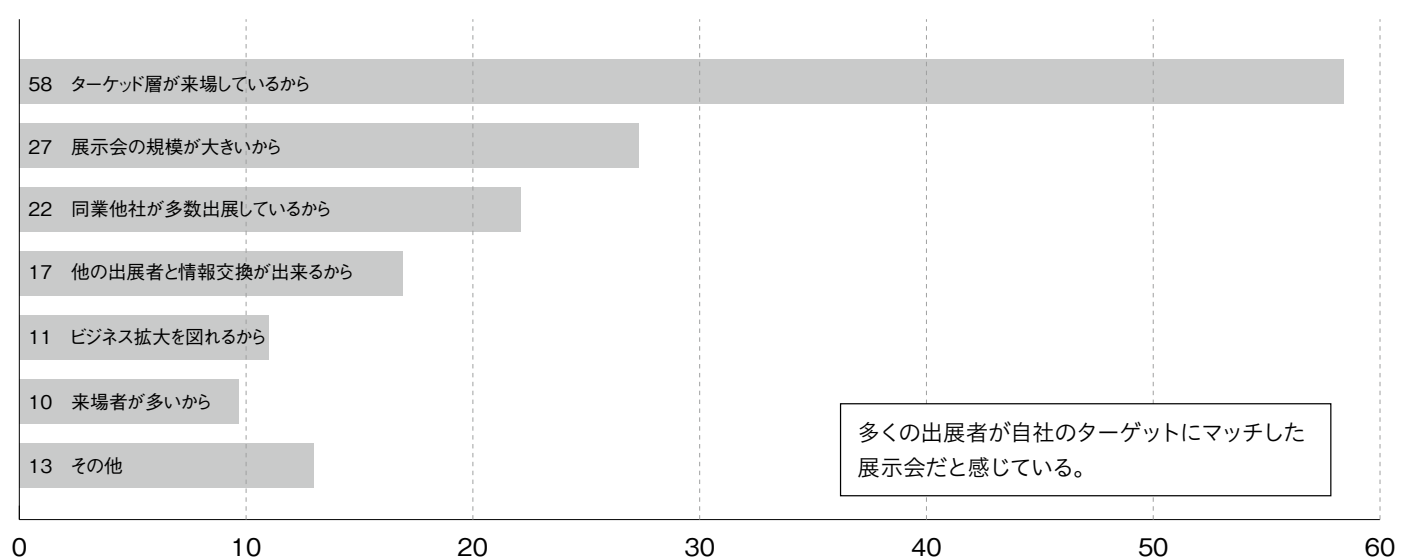
①出展目的 ※複数回答



②出展結果 ※複数回答

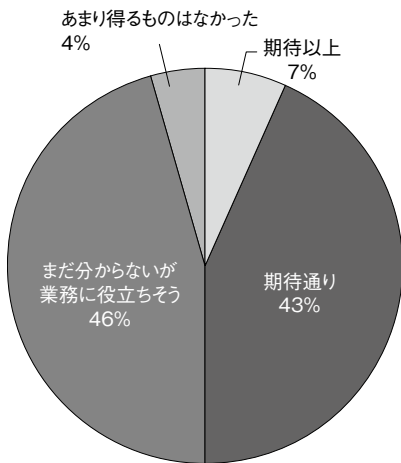


③様々なエレクトロニクス展の中から本展を選んだ理由 ※複数回答

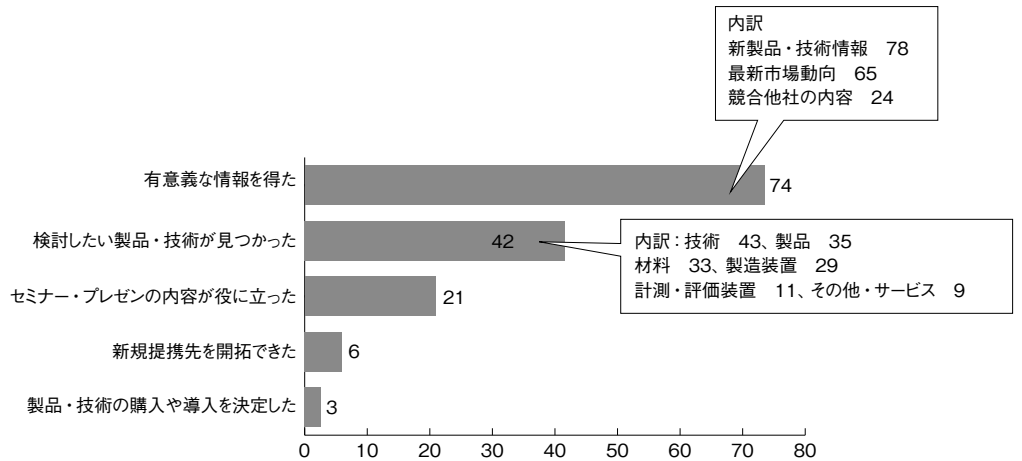


来場者アンケート

①-1 来場成果

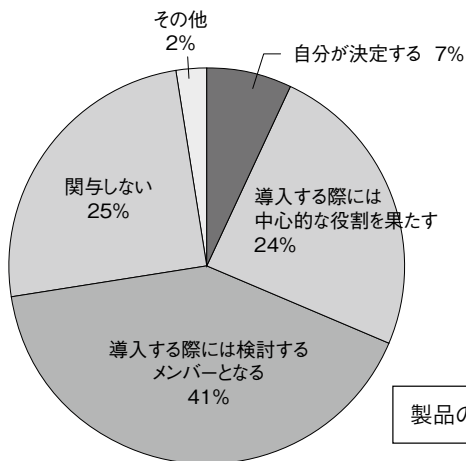


①-2 具体的な成果 ※複数回答



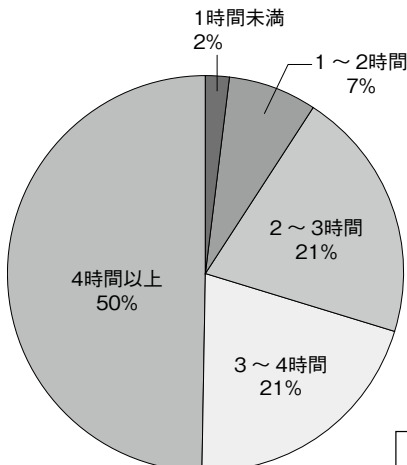
多くの来場者が来場成果を実感し、新製品・技術の情報を得たり検討したい製品・技術を見つけている。

②製品仕込・購入への関与



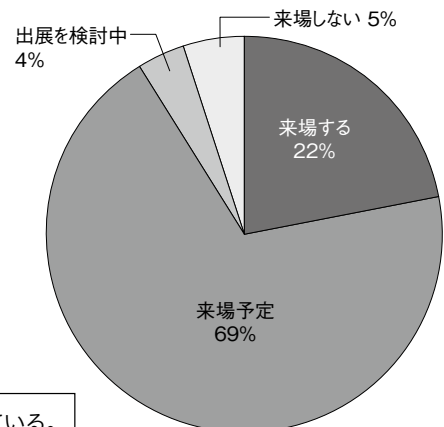
製品の仕入・購入に係る立場にある来場者が多く来場している。

③滞在時間



来場者の多くが時間をかけて展示会場を回遊している。また、9割以上の来場者が次回の来場を予定しており、来場者の満足度の高さが伺える。

④次回開催の来場予定



(1) 関連業界団体との連携強化

メールマガジンの配信や機関誌への広告掲載など相互の展示会においてプロモーション活動を実施。

(2) 広告掲載媒体 (順不同)

月刊EMC/インコム/エレクトロニクス実装技術/オートメーション新聞産経新聞/化学工業日報/グローバルネット/JARA 機関紙/DMカード/電子デバイス産業新聞/電波新聞/日刊工業新聞/日経産業新聞/日本鍍金新報/人とするまのテクノロジー展 横浜 ダイジェスト/プリント回路ジャーナル/メカトロニクス/JPCA NEWS

(3) 海外展示会出展・広告掲載実績

- 2016年8月 18日(木)～20日(土) インド: IPCA EXPO
- 2016年9月 21日(水)～23日(金) インド: Electronica India
- 2016年10月26日(水)～28日(金) 台湾: TPCA Show
- 2016年12月 7日(水)～9日(金) 中国: HKPCA & IPC Show
- 2017年02月14日(火)～17日(金) 米国: IPC APEX Expo
- 2017年03月14日(火)～16日(木) 中国: CPCA Show
- 2017年04月19日(水)～22日(土) タイ: LED & PCB Expo
- 2017年04月25日(火)～27日(木) 韓国: KPCA Show

(4) PRツール製作

国内用招待状(280,000部)、海外用招待状(データ配布)、VIP招待券(40,000部)、ポスター(1,200枚)、フロアマップ(和英)(80,000枚)、カンファレンスマップ(80,000枚)を作成。

(5) メールマガジンの配信

関連する業界団体などの協力により、昨年比2倍以上の配信件数を実現。さらに会期2週間前より毎日配信を実施。



JPCA NEWS 7月号 掲載

2017年展示会主催・運営委員会 委員

2017 展示会運営委員会

委員長 山本 治彦
(JPCA 副会長／超高効率電子回路生産システム研究会)

副委員長 児嶋 一登
(JPCA 理事／(株)京写)

松岡 昇
(ピアメカニクス(株))

委員 猪川 幸司
(JIEP 展示会事業委員会委員長／日本シイエムケイ(株))

青田 広幸
(JISSO PROTEC 2017 運営委員会委員長／
パナソニック スマートファクトリーソリューションズ(株))

泉谷 渉
(ラージェレクトロニクスショー 共催会社代表／(株)産業タイムズ社)

井上 政基
(WIRE Japan Show 共催会社代表／(株)工業通信)

展示会企画委員会

委員長 山本 治彦 (JPCA 副会長)

副委員長 ジュリアン・ベイショア
(JPCA 理事／マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・
ジャパン株式会社)

委員 猪川 幸司 (日本シイエムケイ(株))

泉谷 渉 (株)産業タイムズ社)

井上 政基 (株)工業通信)

兼子 昌和 (日本メクトロン(株))

西村 勤 (パナソニック(株))

小岩 一郎 (関東学院大学)

後藤 哲朗 (株)ニコン)

松本 博文 (日本メクトロン(株))

JPCA 活性化委員会

委員長 岩城 慶太郎 (メルテックス(株))

副委員長 兼子 昌和 (日本メクトロン(株))

委員 高見澤 栄治 (ソマール(株))

JPCAアワード選考委員会

委員長 越地 耕二 東京理科大学

委員 小岩 一郎 関東学院大学

委員 伊藤 日出男 国立研究開発法人産業技術総合研究所

委員 樫場 正男 (株)カヤバオフィス

委員 大島 雅志

委員 豊田 国寿 日刊工業新聞社

委員 于 強 横浜国立大学

委員 野村 和宏 (株)産業タイムズ社

JIEP 展示会事業委員会

委員長 猪川 幸司 (日本シイエムケイ(株))

副委員長 栗原 正英 (一般社団法人日本電子回路工業会)

副委員長 加藤 義尚 (福岡大学)

委員 小日向 茂 (大阪大学)

高野 希 (日立化成(株))

土門 孝彰 (株)秋田銀行)

齊藤 雅之 (株)東芝)

西田 秀行 (ニシダエレクトロニクス実装技術支援)

宝蔵寺 裕之 (株)日立オートモティブシステムズ)

越地 福朗 (東京工芸大学)

松原 孝宏 (京セラ(株))

本多 進 (C-NET)

和嶋 元世 (C-NET)

田畑 晴夫 (大阪大学)

三宅 敏広 (株)デンソー)

大竹 精一郎 (株)デンソー)

渡邊 裕彦 (富士電機(株))

伊藤 寿浩 (東京大学)

平田 勝子 (霞テクノロジー)

白石 洋一 (群馬大学)

小岩 一郎 (関東学院大学)

澤田 廉士 (九州大学)

内木場 文男 (日本大学)

JISSO PROTEC 2017 運営委員会

委員長 青田 広幸 (パナソニック スマートファクトリーソリューションズ(株))

副委員長 富士原 寛 ((一社)日本ロボット工業会)

委員 曾我 信之 (富士機械製造(株))

濱 学洋 (JUKI(株))

太田 裕之 (ヤマハ発動機(株))

JISSO PROTEC 2017 実行委員会

委員長 西村 勤 (パナソニック(株))

副委員長 今井 美津男 (富士機械製造(株))

委員 上田 裕司 (JUKIオートメーションシステムズ(株))

熊谷 立人 (ヤマハ発動機(株))

角屋敷 敏丸 (千住金属工業(株))

生島 直俊 (武蔵エンジニアリング(株))

榎 寿光 (マイクロニックテクノロジーズ(株))

JISSO PROTEC 2017 企画部会

部会長 西村 勤 (パナソニック(株))

副部会長 今井 美津男 (富士機械製造(株))

委員 上田 裕司 (JUKIオートメーションシステムズ(株))

熊谷 立人 (ヤマハ発動機(株))

(順不同・敬称略)

世界唯一にして最大規模!産学連携開催

電子機器2018 トータルソリューション展

The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment 2018

6.6 Wed. ▶ 6.8 Fri.

東京ビッグサイト/東ホール

Tokyo Big Sight, East Hall

出展者募集開始!! Book your space now!!

更にPOWER UPした2018年展でまたお会いしましょう!!

JPCA2018
Show

48th International Electronic Circuits Exhibition
Organizer: Japan Electronics Packaging and Circuits Association

JEPC 2018
Microelectronics Show

32nd ADVANCED ELECTRONICS PACKAGING EXHIBITION
Organizer: Japan Institute of Electronics Packaging

JISSO
PROTEC 2018

20th Jisso Process Technology Exhibition
Organizer: Japan Robot Association (JARA)

 **Large Electronics Show 2018**
Co-Organizer:
Japan Electronics Packaging and Circuits Association
Electronic Device Industry News (Sangyo Times, Inc.)

W **WIRE Japan Show**
2018

Electric wire, Cable, and Connector Exhibition
Co-Organizer: Japan Electronics Packaging and Circuits Association
THE ELECTRIC WIRE & CABLE NEWS (KOGYO TSUSHIN CO., LTD.)

詳細は展示会ウェブサイトへ▶ <http://www.jpca2018.com/>

▶ お問い合わせ先 展示会運営事務局: 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp

本部事務局:

一般社団法人日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2F

TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpca.org